

Compression Molding System

Model PMC1040



PMC1040-D

**Compression molding system
for high quality and low cost production**

用于高质量和低成本生产的压缩成形设备

产品信息



中文

- 采用TOWA专有成型技术的压缩成型系统
- 应用Cavity Down构造实现高品质成型
- 可将裸露状态的Heat sink/Metal shield与基板同时进行封装
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



PMC1040-D



PMC1040-D HS

SPECIFICATION

Items		Unit	Description								
机型		—	PMC1040-S			PMC1040-D			PMC1040-D HS		
框架・基板类型		—	基板・引线框架								
框架・基板尺寸	长度	mm	130—300			130—300			200—260		
	宽度	mm	50—100								
树脂		—	颗粒								
机械时间		sec	Approximately 43			Approximately 43			Approximately 60		
外形尺寸	模组数量	module	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	宽度	mm	3,240	3,880	4,520	3,240	3,880	4,520	4,340	4,980	5,620
	纵深	mm	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
	高度	mm	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
重量		ton	4.5	6.4	8.3	4.7	6.6	8.5	6.0	7.9	9.8
每模成形基板数量		workpiece	1	2	3	2	4	6	2	4	6
料盒放置空间		mm	440								
合模压力		kN／(tf)	127.0—392.0／13.0—40.0								
合模速度		mm／sec	90 (Max.)								
品种切换方式		—	采用KIT更换方式								
使用分离膜的宽度		mm	160 (Max.)								
Heat sink・Metal shield 尺寸		mm	—			—			44—94 (W)×180—253 (L)		

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ